

# 2022年度第2回 先端電子デバイス接着技術研究会 「パワーモジュールの接着」



2022年9月2日（金）Zoomウェビナーによるオンライン開催

【第1部】主催：F3D接着技術研究会 協賛：よこはま高度実装技術コンソーシアム（YJC）

13:30～13:35 開会挨拶 大阪大学 F3D実装協働研究所 所長 菅沼 克昭

13:35～14:20 「パワーモジュール用耐熱封止樹脂の界面強度評価」  
横浜国立大学 澁谷 忠弘 先生

14:20～14:30 ～ 休憩(10分)～

14:30～15:15 「大電流パワーモジュールの実装技術」  
(元)よこはま高度実装技術コンソーシアム 富永 保 氏

15:15～16:00 「車載パワーモジュールの実装動向と接着技術」  
日立Astemo株式会社 技術統括本部 石井 利昭 氏

【第2部】接着技術研究会内会合「先端パッケージの接着に関する課題整理とその取り組み」に向けての検討  
16:15～17:30 会員企業(委員)のプレゼン:会社紹介及び先端パッケージの接着に関する意見(20分/社)

- ①ローム株式会社(中原様)
- ②株式会社巴川製紙所(中西様)
- ③株式会社トクヤマ(浜坂様)